

UV光固化解膠膜與感壓膠

技術特色

UV前具有足夠黏著力，使物件於加工過程中不脫落、飛散。

加工結束後經由UV照射黏性降低且無殘留物，可讓微元件容易取下，本技術能依照製程和基材需求調整UV前後之黏著力。

技術規格

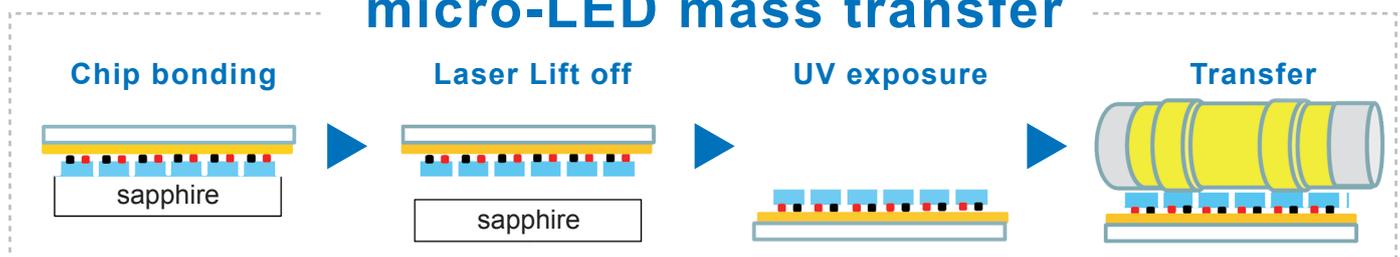
特性		Non-UV type	UV type
基材		PO/EVA/PET玻璃 銅箔 不鏽鋼板	PO/EVA/PET玻璃 銅箔 不鏽鋼板
厚度(um)		5~20	5~20
剝離力 (gf/25mm)	UV前	50~500	100~1000
	UV後	—	≤20

產業應用

UV光固化解膠膜與感壓膠技術可廣泛運用於半導體產業和光電領域。

如晶圓研磨和切割、LED、面板用玻璃基板研磨切割與micro LED巨量轉移等。

micro-LED mass transfer

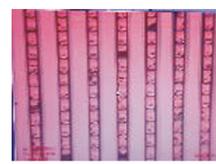


開發現況



Chips on substrate

選擇性轉移區域
(第1、4、7欄晶片被拿取後)



Chips on stamp

Chip size: 100X150μm

